

CLEARFIL SE BOND™

باندینگ سلف اچ (نسل ۶)



یک سیستم باندینگ لایت کیور ، حاوی پرایمر Self-etch و یک عامل باندینگ می باشد. پرایمر بر پایه آب ، آماده سازی همزمان میباشد و عاج در یک مرحله را امکان پذیر می سازد . موونومر MDP به حذف حساسیت پس از ترمیم کمک می کند .

ویژگی ها :

- شروع نسل ۶ باندینگ ها
- سلف اچ (بدون نیاز به اچ و شستشو)
- سیل مارجینال بهتر به دلیل استحکام باند بسیار بالا
- پرایمر Self-etch بر پایه آب و سازگار با پالپ
- بدون حساسیت تکنیکی
- حاوی موونومر MDP
- بدون حساسیت پس از ترمیم
- استفاده بی خطر، سریع و آسان
- بدون دکلسفیکاسیون بیش از حد ormocers
- قابل استفاده برای کامپوزیت ها ، کامپومرها و

موارد کاربرد :

- قابل استفاده برای تمام کامپوزیت های لایت کیور
- برای سیل کردن توبول های عاجی قبل از تحویل اینله و آنله (فلزی یا سرامیکی)
- قابل استفاده برای حساسیت های تحلیل لشه
- ترمیم پرسلن شکسته
- قابل ترکیب با سایلن پرسلن

آماده سازی سطوح سرامیکی :

وقتی یک رستوریشن ساخته شده از سرامیک هیبرید یا کامپوزیت ، مدنظر است ، باید ابتدا برای بهتر ساختن خصوصیات سطحی سرامیک ، روی آن از سایلن استفاده کرد . برای ساخت سایلن ، یک قطره از پرایمر Clearfil SE Bond با یک قطره از Clearfil Porcelain Bond Activator (سایلن پرسلن) در یک ظرف مخصوص مخلوط می گردد . محل مورد نظر را با محلول به مدت ۵ ثانیه آغشته نمایید و سپس با هوای ملایم خشک کنید .

* دستور کار فارسی در هنگام تهیه محصول تقدیم میگردد .

